

透 明 耐 熱 性 樹 脂

有機エレ材研(JOEM)

【電子情報通信学会有機エレクトロニクス専門委員会との共催】

《日 時》 2006年10月23日(月) 1時~4時20分

《会 場》 機会振興会館 地下3階2号室

(Web site: <http://www.jspmi.or.jp/kaikan.htm>)

(所在地:東京都港区芝公園3-5-8 TEL:03-3434-8211)

《プログラム》

- 13:00~13:35 「有機材料の耐熱化技術」
富士キメラ 幸田 靖男
- 13:35~14:10 「耐熱性半導体封止樹脂」
京セラケミカル 内田 健
- 14:10~14:45 「ゼオネックスの高機能技術」
日本ゼオン 小原 禎二
- 14:45~14:55 休憩(10分)
- 14:55~15:30 「シクロヘキサジエン系高分子透明耐熱性樹脂」
旭化成 宍戸 淳一
- 15:30~16:05 「LCP(液晶ポリマー)の高機能化」
住友化学 岡本 敏
- 16:05~16:20 補充討論・総括討論

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は要旨集代として1,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 今回に限り懇親会はありません。

参加登録: 参加登録、登録の変更は、10月18日(水)までに、次へお願いします。

(!) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(Yahooなどでも検索できます)

(2) FAX: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。